

ハードウェア 開発評価サービス

ハードウェア設計、治具開発の中で、
簡単かつ工数のかかる業務などをオフショア化し、
御社の貴重な人財を重要な業務に
シフトしませんか？



製品の構想から量産までの一気通貫のサービスを提供します。

中国リソースを使った低コスト開発・評価に加え、ソフトウェアサービスの経験を活かした設計効率化を提案し、
お客様に満足していただけるハードウェアサービスを提供します。



製品構想

1

- ・基板構成検討、実現案提案
- ・中国内の部品調査と選定
- ・製品化に必要な調査

「IEC60601規格に準拠した提案」



設計

2

- ・回路、ソフト、FPGA設計
- ・機能設計・詳細設計
- ・メカ設計
- ・製図(回路図、メカ図)



試作・開発

3

- ・基板レイアウト設計
- ・ソフトウェア開発
- ・基板製造、試作
- ・メカパーツ製作

*金型・3Dプリンタ使用



量産・評価

4

- ・動作確認、不具合検証
- ・波形評価、判定
- ・EOL部品置換調査
- ・代替部品市場調査
- ・波形評価、レポート作成

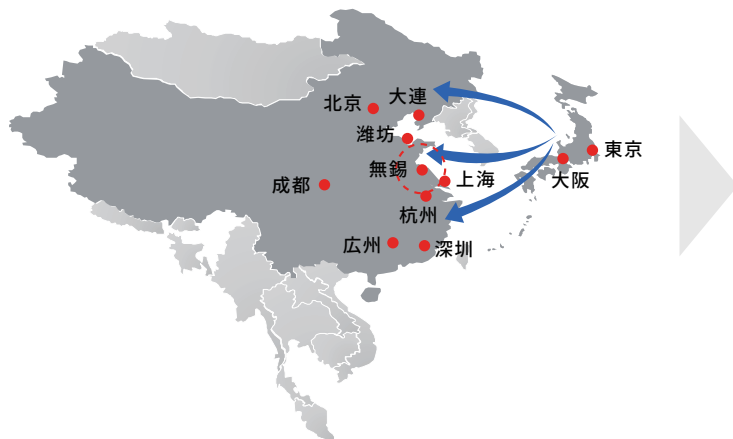


弊社実績

Bluetooth	RFID
Wifi	NFC
4G/LTE	加速度センサー
Lora	ジャイロセンサー
液晶パネル、タッチパネル	圧電センサー
スピーカー	心拍センサー
UWB	振動センサー

弊社オフショア拠点紹介

IT・BPO・R&Dサービスで全11のオフショア拠点を保有。
ハードウェアチームは江蘇省無錫市に拠点を構えています。



サービスライン	江蘇省 無錫市 新区 ソフトパーク
ハードウェアエンジニア人数	17名 (2023/04現在)

サービスライン	拠点
IT サービス	大連、濰坊、上海、杭州、深圳
BPO サービス	大連、広州
R&Dサービス	北京、大連、成都、無錫

Pactera オフショア拠点の強み



プロフェッショナル部隊によるスピーディーな開発、短期間で試作が可能です。



安価なリソース(人的・調達)の活用による低コスト・量産開発の実現が可能です。



中国国内の最新の技術や部品の入手経路の活用による高品質な開発を実現します。

Pactera オフショア拠点の体制

製品化においては、ハードとソフトの連携が重要なため、ハードとソフトのエンジニアが常に情報共有できる環境を整え、素早い判断、行動でプロジェクトを推進することで、スピード感を持った開発を進めております。



ソフトウェアチーム



ハードウェアチーム